第四节董事会报告一、概述2014年，在国家一系列政策密集出台的环境下，在国内市场强劲需求的推动下，我国集成电路产业整体保持平稳较快增长，开始迎来发展的加速期。根据中国半导体行业协会统计，2014年中国集成电路产业销售额3,015.4亿元，同比增长20.2%；其中，设计业增速最快，销售额1,047.4亿元，同比增长29.5%；晶圆制造业销售额712.1亿元，同比增长18.5%；封装测试业销售额1,255.9亿元，同比增长14.3%。国际市场竞争加剧，国内政策、资金环境改善都将促使全球产业格局发生改变。随着国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》（以下简称“纲要”）和国家集成电路产业投资基金项目启动，目前，国家集成电路产业基金一期预计总规模已超1,000亿元，各地也在纷纷出台集成电路产业政策并推出相关产业基金，推动集成电路产业发展。同时，在新型工业化、信息化、城镇化、以及农业现代化建设的带动下，国内集成电路市场仍保持着旺盛增长势头，并不断激发业界的创新活力。“不积硅步，无以至千里”，多年来，公司在市场资源、技术能力、产能规模、运营水平、团队合作等各方面的积累，加上集成电路行业发展前所未有的政策支持，公司必将牢牢抓住这一难得的大机遇，实现公司大发展。报告期内公司主要完成了以下几个方面工作：（一）市场开拓方面优化客户结构：公司的客户结构已基本形成了欧美、亚太、国内三分天下的局面，每类产品都有业界一流客户，避免了依靠单一市场带来的风险；提高产品档次:2014年无线通讯及数字多媒体等技术领域的设计公司在公司的订单呈爆发性增长;与国内知名设计公司实现了战略合作，采用先进的WLP和FC工艺生产智能手机芯片产品；提升市场影响：在南通、台湾举办了两次“心”与“芯”相融客户联谊活动，得到客户的高度评价，起到了改善客户关系和提升公司形象的目的；拓展海外市场，重点拓展了台湾市场，2014年公司专设人员统一协调处理台湾地区业务，取得了较好的效果，2014年台湾的销售额达到4.13亿元，同比增长82%。（二）技术创新方面产品创新：国内首家28纳米12寸CopperPillar顺利投产，同时，FlipChip（倒装焊）产品线也顺利建成投产，标志公司拥有了当今最先进的封装技术及产线；超宽框架QFN顺利量产；PDFN双面散热的技术开发成功；ClipBond通过客户验证；科研创新：国家“02”专项顺利扎实推进。公司申报的2014年度“02”专项项目（课题）已获《极大规模集成电路制造及成套工艺》实施管理办公室立项批复，标志着公司作为封装测试的国家队成员，将持续获得国家的政策扶持；2014年，公司技术中心被认定为第二十一批享受优惠政策的国家认定企业技术中心；2014科技获奖情况：中国半导体创新技术产品：IPM封装技术产品国家重点新产品：IPM26家电用IGBT模块封装技术产品国家火炬项目：FILPCHIP封装技术开发及产业化江苏省高新技术企业国家火炬高企江苏省高新技术产品：FCCSP封装技术产品江苏省科学技术奖：WLP封装技术产品两化融合示范企业管理创新先进企业（三）内部管理方面1、组织架构调整“不谋全局者不足以谋一隅，不谋万世者不足以谋一时”，2014年公司新设置了策略办、工作作风建设小组两个职能部门，策略办的成立旨在提升公司在新时期新情况下跨越式发展需要的策略层面的规划能力；工作作风小组着重建设管理干部的勤勉敬业、求真务实、团结拼搏、不断学习、敢为人先的进取精神。2、人力资源2014年，公司加快了高端管理、技术人才引进步伐，引进了具有世界半导体知名企业管理经验的国内及外籍高端人才9名，他们在各自的岗位上发挥了重要的作用。2014年，公司员工队伍不断扩大，员工收入明显增长，公司还将进一步考虑分配制度的改革，让员工在公司发展的同时，通过贡献大小，收入同步提高。（四）产业布局方面公司全资子公司江苏通富微电子有限公司苏通产业园项目正在进行土建招标，公司在苏通产业园实施的智能电源芯片封装测试项目，预计建设期2年。公司定向增发申请已顺利过会，拟募集资金不超过12.8亿元。增发成功后，将为公司实现更大发展提供强有力的资金保障。二、主营业务分析1、概述公司主营业务为集成电路封装测试。报告期内，以智能手机为主的智能终端市场快速发展带动了公司元器件产品销售的增长，新产品研发及市场开拓进入收获期。2014年，公司全年实现营业收入20.91亿元，同比增长18.30%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长99.18%。单位：元同比发生变动30%以上的原因说明：期间费用较2013年同比增长33.33%，研发投入较2013年同比增长85.53%，主要是报告期内，公司根据市场需求情况，加大了项目研发及技改力度所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况根据年初制定的2014年度生产经营目标，全年计划实现营业收入21.20亿元，实际2014年度营业收入20.91亿元。报告期内，公司按照既定的发展战略和生产经营目标开展各项工作，一方面依据不断变化的市场，着重推进公司优势产品，积极调整产品结构，提升公司市场影响力；另一方面，继续推进以低成本为重点的技术研发与应用工作，提升公司产品竞争力的同时，提高了2014年度公司运营效益。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用2、收入说明2014年，公司全年实现营业收入20.91亿元,较2013年同比增长18.30%。公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用报告期内，公司库存量较2013年增加38.81%，主要是公司生产量增加所致。公司重大的在手订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用公司主要销售客户情况公司前5大客户资料√适用□不适用3、成本行业分类单位：元产品分类单位：元说明2014年度，公司主营业务成本16.91亿元，较上年同期增加14.73%，占营业成本的99.95%，主要是公司集成电路产量较上年增加所致。公司主要供应商情况公司前5名供应商资料√适用□不适用4、费用单位：元同比发生变动30%以上的原因说明：（1）管理费用较2013年同比增长46.11%，主要是报告期内，公司根据市场需求情况，加大了项目研发及技改力度所致。（2）营业税金及附加较2013年同比增长43301.27%，主要是报告期内公司城市维护建设税、教育费附加增加所致。5、研发支出单位：元报告期内，公司根据市场需求情况，加大了项目研发及技改力度，全年研发支出额1.62亿元，同比增加了85.53%。公司开展的研发项目主要是国家科技重大专项02专项等研发项目，通过多项先进集成电路技术工艺开发及产业化项目的实施,有利于提升公司自主创新能力及核心竞争力,符合公司长远发展的需要。6、现金流单位：元相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用经营活动产生的现金流量净额较2013年同比增长34.14%，主要是报告期内公司主营业务收入增加所致；投资活动现金流入小计较2013年同比增长111.90%，主要是赎回银行理财产品所致；投资活动现金流出小计较2013年同比增长219.03%，主要是为扩大产能，增加设备投入所致；投资活动产生的现金流量净额较2013年同比增长372.93%，主要是为扩大产能，增加设备投入所致；筹资活动现金流入小计较2013年同比增长102.17%，主要是本期银行借款增加所致；筹资活动现金流出小计较2013年同比增长58.32%，主要是本期偿还银行借款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较2013年同比增加，主要是银行借款增加所致；现金及现金等价物净增加额较2013年同比下降，主要是本期购置设备等增加导致期末现金及现金等价物减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用三、主营业务构成情况单位：元公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元，2、负债项目重大变动情况单位：元3、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位：元报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否五、核心竞争力分析随着集成电路产业“后PC时代”的来临，以智能手机、平板电脑等为主的移动互联终端产品继续成为产业发展的重要支撑。此外，医疗电子、安防电子、智能可穿戴产品等新兴领域的发展，对市场的影响力将逐渐增强，这些新兴电子产业的发展对集成电路产品的要求也会越来越高。公司围绕主业发展战略，遵循“一站式解决方案”经营理念，倡导“绿色环保”的发展潮流，坚持技术创新，不断推出满足市场需求、高科技、高附加价值产品，力争使公司产品技术始终保持行业领先水平。（一）产品优势公司专业从事集成电路封装、测试业务，可提供从芯片测试、组装到成品测试的“一站式”（OneStopSolution）服务。公司拥有几十个系列、五百多个品种产品，并提供微处理器、数字电路、模拟电路、数模混合电路、射频电路的FT测试及PT圆片测试服务。公司在中高端封装技术方面占有领先优势。（二）技术研发优势公司建有国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台，拥有一支专业的研发队伍，专职从事新品、新技术开发的科研人员达五百余人。并与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了长期合作关系，聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。公司承担了“十一五”、“十二五”国家科技重大专项（“02”专项）“先进封装工艺开发及产业化”、“国产关键设备、材料应用工程”和“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”项目。专项实施以来，公司取得丰硕的技术创新成果。同时，公司通过自主创新，不断改进和研发新产品，提高产品质量，公司技术水平、产品结构不断得到优化。公司拥有MCM、SiP、QFN、BGA、汽车电子封装技术、BUMP、WLP、Cupillar等多项技术知识产权。截至报告期末，公司已累计申报专利321项，目前享有的授权专利125项，其中授权发明专利46项，实用新型专利78项，美国专利1项（美国专利为发明专利）。此外，还有一批专利正在编制申报之中。（三）对外合作优势公司紧紧抓住国际产业调整的难得机遇，积极承接世界集成电路封测产业的转移。近年来，公司充分发挥技术水平和产业规模优势，全力推进对外合作向更深层次发展。目前，德州仪器、意法半导体、富士通等世界排名前20位的半导体公司有半数以上与公司长期合作，国内许多优秀的设计公司也是公司的优质客户。（四）产业政策扶持的优势国家政策鼓励做大做强骨干企业。“十二五”时期，国家科技重大专项的持续实施，公司作为国家重点集成电路企业和国家科技重大专项承担单位，将有望得到国家产业政策更多的扶持。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况√适用□不适用（2）持有金融企业股权情况□适用√不适用公司报告期未持有金融企业股权。（3）证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明□适用√不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况√适用□不适用单位：万元（2）衍生品投资情况√适用□不适用单位：万元、、（3）委托贷款情况□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况√适用□不适用（1）募集资金总体使用情况√适用□不适用单位：万元一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590号文核准，本公司通过深圳证券交易所系统于2010年11月向社会公开增发人民币普通股（A股）股票5,906.67万股，发行价为每股16.93元。截至2010年11月22日，本公司共募集资金99,999.92万元，扣除发行费用3,773.90万元后，募集资金净额为96,226.02万元。上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第173号验资报告验证。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。1、以前年度已使用金额截至2013年12月31日，增发募集资金累计投入募投项目96,217.50万元，尚未使用的金额为1,475.03万元（其中，募集资金8.52万元，专户存储累计利息扣除手续费1,466.51万元）。2、本年度使用金额及当前余额根据本公司2014年3月27日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司将节余募集资金永久性补充流动资金。本公司募集资金账户，包括在中国建设银行股份有限公司南通城中支行开立的32001642736059585889账户、在中国工商银行股份有限公司南通青年路支行开立的1111820129100379236账户已办理销户手续，募集资金已全部使用完毕。二、募集资金的管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，于2008年3月14日经本公司董事会二届十六次会议审议通过，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年6月28日经本公司董事会四届十八次会议审议通过修订。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年11月起对增发募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况截至2014年12月31日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，相关募集资金账户均已办理销户手续。（2）募集资金承诺项目情况√适用□不适用单位：万元（公3）募集资金变更项目情况□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。4、主要子司、参股公司分析√适用□不适用主要子公司、参股公司情况单位：元公司子公司、参股公司情况说明公司全资子公司江苏通富微电子有限公司正在建设期，还未产生业绩；公司参股公司无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司本报告期的净利润或投资收益对公司净利润影响小于10%，且经营业绩未出现大幅波动，故未进行详细披露。报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用5、非募集资金投资的重大项目情况□适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、公司控制的特殊目的主体情况□适用√不适用八、公司未来发展的展望（一）公司所处行业发展趋势1、集成电路行业正迎来新的成长周期。随着发达国家走出低谷，全球经济回暖，市场重展活力，将为全球和我国集成电路产业带来新的增长。根据ICInsights研究，2013年全球经济正处在2011-2012年全球经济衰退后的回升期。2013年全球半导体市场也正是走出了2011-2012年的低谷，获得较为明显的增长。ICInsights预测以后半导体市场将逐年增长，形成延续3-4年全球半导体市场新的成长周期，2016年全球半导体市场将达到成长周期的顶峰。2、国内信息安全角势凸显发展集成电路产业的重要性。2014年，由于信息安全角势严峻，国家信息安全战略上升到了一个前所未有的高度，集成电路国产化率提升迫在眉睫。今年“两会”期间，集成电路产业首次被写进政府工作报告，国务院领导密集调研集成电路产业。作为国家信息安全和电子信息行业的基础，集成电路产业被关注度不断提升。3、国家和各地方的扶持政策密集出台。2014年，《国家集成电路产业发展推进纲要》出台，在当前我国集成电路产业发展的关键时期，《纲要》作为今后一段时期指导我国集成电路产业发展的行动纲领，将为我国集成电路产业实现跨越式发展注入新的强大动力。《纲要》出台后，备受关注的国家集成电路产业投资基金开始落地，首批规模从最初的1000亿元提升到1200亿元，同时，各地也纷纷推出地方版集成电路扶持政策。目前，北京、安徽、天津等地相继出台了集成电路扶持意见，通过设立投资基金，重点支持地方龙头企业在集成电路领域进行整合做大。其中，安徽提出2017年省内集成电路产值达300亿元以上，2020年总产值达600亿元，支持合肥等市建立集成电路产业发展基金。4、集成电路封装测试需求巨大。集成电路可广泛应用于计算机、消费类电子、网络通信等终端领域，随着中国信息产业的不断发展，计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等主要需求领域未来几年都将呈现高速增长的态势，再加上我国三网融合、3G及4G网络以及物联网等新兴应用领域的不断扩展，终端市场需求空间巨大。从应用领域来看，智能手机、平板电脑等智能终端将继续支撑集成电路产业快速发展。有关机构预计智能手机2014年全球出货量达到13亿部，增长26%，2015年将继续增长12%，总量超过14亿部；2015年全球平板电脑出货量将超过PC。物联网等领域将推动集成电路产业的繁荣。物联网和可穿戴设备正在崛起，很多机构判断，在不久的将来，联网的设备将不再仅限于智能手机、电脑等，会覆盖到智能家居、交通物流、环境保护等多个领域，物联网将是下一个推动世界高速发展的“重要生产力”，是继通信网之后的另一个万亿级市场。2014年，许多企业包括芯片、系统及软件企业都已经着手向物联网领域推进，年内发生的众多并购活动，都与物联网和可穿戴设备有关，如谷歌收购智能家居公司、三星收购物联网公司、英特尔收购智能手表公司等。4G智能手机、物联网产业快速发展，将为集成电路企业提供更多市场空间。我国移动通信开始从3G时代进入4G时代，2014年全国移动电话用户总数达12.8亿户，其中4G用户超过8000万，4G终端普及速度超出预期；我国物联网产业发展迅猛，在智能城市、智能交通、工业监控等方面的需求不断提升，据中国物联网研究发展中心报告，2015年中国物联网市场规模将达7500亿元，物联网技术的发展带来对各种感测器及低功耗、小尺寸芯片需求快速攀升。5、国外技术支持，助力集成电路技术更新换代。在国家对信息安全建设重视程度提高、扶持政策相继出台、移动互联市场进一步发展的背景下，国外知名公司也纷纷向内地优秀企业抛出橄榄枝，愿意开展技术合作，这将为中国集成电路产业发展提供强力技术支撑。（二）公司面临的市场竞争格局及竞争优势在市场竞争格局方面，目前国内集成电路封装测试企业已构成外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。其中，国际大型半导体企业纷纷在华建厂，无论在规模还是技术水平上占据着明显的优势。但同时，我国作为集成电路最大消费国，电子产品最大制造国，集成电路代工发展最快国，从成本和物流周期角度出发，必将进一步加快全球集成电路代工向中国国内转移的步伐。加之政策扶持给中国大陆的封测企业提供了一个赶超世界一流半导体企业的绝佳机会。近年来，公司紧跟市场与客户需求，加快产品、工艺开发与创新，成功开发出新款BGA产品、超薄QFN产品、eMMC产品，铜线技术的应用扩展到BGA/QFN/LQFP/LPC/POWER等所有系列产品上，Bump、FC等先进封装产品取得成效，相关客户开发进展顺利；在产品结构上，在保持传统优势产品的基础上，BGA、QFN、POWER等优势产品实现了大幅增长；在客户结构方面，以市场为导向，及时做好区域客户结构调整优化工作，台韩地区市场开拓，卓有成效。随着公司竞争能力的不断增强，公司开拓优质客户的能力不断提高，为公司收入的增长奠定了坚实的基础。（三）公司发展战略及规划1、发展战略为顺应当前良好的市场环境，公司内部推出三年翻一番的战略目标，并朝着该目标努力奋进。具体包括：公司坚持“服务与创新、进取与和谐”的经营理念，贯彻“顾客满意第一”的经营宗旨，为客户提供“一站式解决方案”；坚持发展主业的指导方针，提升主业盈利能力，采用自身内涵式发展和兼并重组外延式发展相结合的模式，促进公司产品结构调整和转型升级；坚持科技创新的发展理念，引进国内外高层次人才，不断推出满足市场需求、高科技、高附加值的产品，使公司产品技术始终保持国内领先、国际一流水平；坚持“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”的企业文化，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，促进公司与社会的和谐发展；抓住目前集成电路发展的大好时机，利用国家对集成电路行业的高度重视和强力扶持，积极承担国家科技重大专项等项目，在先进封装技术研发与应用、知识产权方面取得重大突破和创新，努力使公司成为世界级的集成电路高端领域封装测试服务商，力争早日进入全球封测行业前十强，并努力使排名不断向前。2、公司2015年度经营目标2015年度生产经营目标为全年实现营业收入28.00亿元。该生产经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性。为实现2015年度生产经营目标，公司将重点做好以下几个方面工作：（1）抓产业布局，抓集团化建设公司已开始了跨域发展的脚步，新设立的全资子公司——江苏通富微电子有限公司苏通产业园项目开工建设是公司迈出崇川的第一步。未来为了抓住国家战略需求，公司将在更多的地域甚至海外进行更多的战略布局。2015年公司将推进集团化建设，着眼战略，对集团体系建设做出系统规划。一是着眼国家“十三五”期间重点发展战略，这将成为企业集团建设的前提和依据，决定着企业集团建设的方向；二是着眼于企业集团自身的发展战略。根据企业战略发展或战略转型的要求，提出能够促进战略目标实现或战略转型的价值理念，进而转变为各级管理者和员工的行为方式、促进战略目标实现的内在动力。公司将致力于建设一个正规化、国际化与持续化的企业集团的企业领导层，以“制度和文化”为中心打造一个战略管理者阵营。（2）抓市场开拓，抓企业品牌影响力2015年，公司将着力继续保持国内、亚太、欧美三足鼎立的态势，着重培育国内有高端封装需求的设计公司，实现共同成长；利用现有台湾资源平台，持续发展台湾高端封测业务；加强与TI、ST等传统大客户的关系，利用明年北美将要设立联络处的优势，开发一批北美设计公司。21世纪是品牌营销的年代，通富微电需要营建自己的品牌形象，推广自己的品牌。广告、公关、媒体、甚至公益事业都是公司制造品牌加大宣传，促进销售额增加的一种手段。2015年我们会继续在台湾、美国举行公司推介会，让更多的客户了解公司，选择公司。（3）抓产能扩充，抓工厂智能化建设加速做好崇川工厂技改填平补齐，满足市场对于产能的需求。做好苏通厂区的建设工作，策划并组织好产线的搬迁。2015年公司将加快工厂智能化建设，实现智能化生产系统及过程，以及网络化分布式生产设施的设立，建立涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用。智能工厂的建设将大大降低人力需求，提供生产效率，使得公司的产能得到进一步的释放。（4）抓队伍保障，抓团队融合加大人才的招聘力度，引进高端人才，保持一支优秀的不断壮大的员工队伍，为公司发展助力升级。围绕公司的发展计划，随着公司国际化程度的加深，未来将有越来越多的人才加入到公司的大家庭，“五音不同声而能调，五味不同物而能和”，如何将不同语言、不同文化的海外人才与本土人才在融合中追求卓越，真正形成人才集聚效应，将是明年人才建设工作的重点。3、为实现公司发展战略的资金需求及使用计划为保证公司当前业务所需，实现2015年度经营生产目标，完成在建投资项目，并为今后的发展做适当准备，公司计划2015年内在设施建设、生产设备、动力供应等方面投资约7.4亿元。公司非公开发行已获证监会批准，争取明年上半年完成定向增发，募集资金不超过12.8亿，为公司实现更大发展提供强有力资金保障；公司还将全力争取国家产业发展基金、地方集成电路产业基金及国开行的优惠贷款；同时，通过积极承担国家科技重大专项，继续获得国家专项资金支持；维护好银企关系，确保在需要银行信贷资金时，能够快速得到银行贷款。（四）公司的风险因素及应对措施1、行业与市场波动的风险全球半导体行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，同时，如果产品市场竞争激烈，将会影响产品价格，对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业波动给公司带来的经营风险。2、新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险目前新兴产业、智能产业的发展对集成电路产品的要求也会越来越高。公司通过承担国家“02”专项，已经取得一定的科研成果。公司研发的新技术、新工艺、新产品在产业化过程中，如出现一些波折或反复，将给公司生产经营造成一定影响。对此，公司通过引进高层次研发人才，主攻技术含量高、市场需求大的新产品，努力在技术研发层面上少走弯路；公司核心技术骨干和管理力量也将优先服务于新技术、新工艺、新产品，配合客户做好产品认证工作，提前预测产业化过程中有可能出现的问题，做好对策分析工作，缩短客户认证时间，确保新产品如期产业化。3、原材料供应及价格变动风险公司封装测试所需主要原材料为引线框架、键合丝和塑封料。公司主要原材料国内均有供应，公司有稳定的供应渠道。但公司外销业务比例较高，境外客户对封装的无铅化和产品质量要求较高，用于高端封装产品的主要原材料必须依赖进口。因此，不排除中国原材料市场供求关系发生变化，造成原材料价格上涨，以及因供货商供货不足、原材料涨价或质量问题等不可测因素，或者境外原材料市场发生变化，影响公司的产品产量和质量，对公司经营业绩产生一定影响。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。除下列事项外，公司其他因会计政策变更导致的影响不重大。会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目影响2013年金额根据企业会计准则第2号的要求：董事会审议①长期股权投资-15,000,000.00对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，通过并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。②可供出售金融资产15,000,000.00报告期内，公司不存在重要会计估计变更。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用报告期内，公司新设立一家全资子公司江苏通富，故公司将江苏通富纳入合并报表合并范围。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用2014年9月，公司根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2014年修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策及表决程序等作出修改，提出了差异化现金分红政策，进一步完善了公司利润分配方案相关的决策程序和体制。公司章程的修改方案已经公司第四届董事会第十八次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过，修订后的《公司章程》于2014年7月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告期，公司严格按照公司利润分配政策执行。公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况1、2012年半年度利润分配方案：以公司现有总股本649,866,720.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金股利9,748,000.80元（含税）。2012年10月19日公司实施了该利润分配方案。2012年年度利润分配方案：以2012年12月31日的总股本649,866,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,997,334.40元（含税）。2013年6月26日公司实施了该利润分配方案。2、2013年年度利润分配预案：以2013年12月31日的总股本649,866,720股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,997,334.40元（含税）。2013年度，公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。3、2014年年度利润分配预案：2014年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表单位：元公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案√适用□不适用十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案□适用√不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。十五、社会责任情况√适用□不适用公司以“以人为本、产业报国、传承文明、追求高远”为企业文化，始终以为股东、为客户、为员工、为社会创造价值为己任，积极保护职工合法权益，诚信对待客户、供应商，积极从事环境保护和有关公益事业，积极促进公司与社会的协调、和谐发展。2012年，公司导入了电子行业公民联盟（EICC）行为守则，根据EICC行为守则要求进行了自查，公司经营行为基本符合相关要求。EICC行为守则是该联盟制定的一整套标准，以确保电子行业供应链提供安全的工作环境，工人获得尊重和尊严，并且企业在经营中承担环保责任并遵守道德规范。在职工权益保护方面：公司遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保护职工的合法权益。公司建立健全了劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，杜绝事故的发生。公司建立了职业培训制度，采用外部与内部培训相结合的方式积极开展各项培训工作，为职工发展提供更多的机会。公司建立了职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有的合法权益。公司高度重视和支持工会依法开展工作，资助工会组织了拔河、乒乓球、羽毛球、富士通足球大会等丰富多彩的内部友谊赛活动。关心和重视职工的合理需求，春节期间，公司给予员工各项关怀，为南通地区以外的员工给予报销来回路费等。公司一直致力于保护劳动者合法权益的工作，更加全面、科学规范地保护职工权益，为员工提供安全和健康的工作环境，并将与工作有关的伤害和疾病的发生率绛到最低。2013年，取得了BVC认证中心对公司的OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系的认证证书，并通过第一次监督审核。在客户、供应商和消费者权益保护方面：公司以自主掌握核心技术为发展动力，产品技术指标达到国际先进、国内领先的水平，产品质量稳定优异。公司不断完善各项内控制度，在销售、采购、工程建设、财务等各环节建立了严格的监督程序。公司在经营中严守商业道德，妥善保管供应商、客户信息，严格遵循保密协议，并为客户提供良好的售后服务。在环境保护和可持续发展方面：公司始终贯彻节能减排、低碳环保、持续发展理念，在生产全过程控制污染物的产生和能源的消耗,得到各级政府的肯定与表彰,先后获得“江苏省节能先进企业”、“江苏省节水型示范企业”，“南通市节能节能减排先进单位”称号，2014年公司启动了能源管理体系建立工作，同时继续加大节能投入，实施了动力系统优化及能效提升、磨划片废水回收处理与利用、压缩热回收利用、集成电路表面处理生产线优化等节能减排项目,都收到很好效果。环境监测指标全年达标，连续9年获得省或市里的“绿色企业”的称号。在公共关系和社会公益事业方面：公司在生产经营活动中始终遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。公司在做好生产经营工作的同时，在力所能及的范围内，积极参加扶贫济困等社会公益活动。作为南通市慈善总会副会长单位，公司每年积极参与南通市多个慈善项目。2014年度，继续向南通慈善会捐助了56万元。同时，公司内部在2008年成立了“南通华达基金”，用于资助集团公司困难职工以及周边社区困难家庭。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□是√否□不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□是√否□不适用报告期内是否被行政处罚□是√否□不适用十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用☑不适用、。、。、。益民基金管理有限公司、中信证券、国鸣公司基本情况、发展趋势、2014年07月11日公司接待室实地调研机构投资管理有限公司、中投证券、东方证券、行业状况等，未提供资料。申银万国、长江养老保险股份有限公司2014年09月02日公司接待室实地调研机构东方证券、东北证券、阳光资产管理股份有限公司、大和证券、大和资本市场香港公司基本情况、发展趋势、有限公司、野村资产管理株式会社、瑞穗信托银行行业状况等，未提供资料。2014年11月07日公司接待室实地调研机构承川资本、德邦基金管理有限公司、毕盛资产管理有限公司、泰康资产管理有限公司、国金证券、阳光资产管理股份有限公司、兴业证券、中邮创业基金管理有限公司、天风证券公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。2014年11月12日公司接待室实地调研机构华夏基金、凯基证券公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。2014年11月27日公司接待室实地调研机构广发证券公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。2014年12月24日公司接待室实地调研机构国信证券公司基本情况、发展趋势、行业状况等，未提供资料。

标注数量；223